

# ウェットコーティング/スパッタリング 受託加工

## 特長

ウェットコーティング機、スパッタリング機を有しており、ウェット・ドライの組み合わせによる高機能膜の一貫生産が可能です

## ■ウェットコーティング

UV硬化・熱硬化により、機能膜を積層できるウェットコーターです。フィルム基材をロール to ロールで走行させて機能塗料を連続塗工します。薄膜、厚膜塗工に対応できます。また、表面処理としてコロナ処理を設置しており、塗膜密着性を確保しやすい設備です。

項目	単位	1号機	2号機	3号機
フィルム厚	μm	50~188	38~188	38~188
フィルム幅	mm	700~1350	600~1600	600~1600
クリーン度(塗工ヘッド部)	/ft <sup>3</sup>	クラス 1000	クラス 1000	クラス 1000
塗工方式	-	グラビアコーター	グラビアコーター、ダイコーター	グラビアコーター、ダイコーター
塗工膜厚(Dry)	-	~35μm	~15μm(グラビアコーター)	15μm~200μm(ダイコーター)
ライン速度	m/min	5~20	5~20	5~20
塗工可能品種	-	ハードコート、薄膜コート	ハードコート、薄膜コート	粘着材、ハードコート
自動外観検査機	-	有	有	有
UVランプ	-	有	有	有
コロナ処理	-	有	有	有

## ■スパッタリング

金属酸化物薄膜や金属薄膜がロール to ロールプロセスにて成膜可能です。フィルムのフリーテンション加熱(アニール)による耐熱寸法安定化処理やスリット加工も可能です。

項目	単位	I	II	III
方式		走行式DCマグネトロンスパッタリング		
フィルム幅	μm	100~188	50~188	50~188
フィルム幅(有効幅)	mm	Max.770 (660~720)	Max.1,250 (1,000~1,150)	Max.1,250 (1,000~1,150)
ターゲット基盤 (同時成膜可能基数)	基	3 (2)	4 (2)	4 (2)
メインドラム温調	℃	40~150	40~150	-10~150
実績フィルム素材		PET・COC・COP		

本特性値は測定値であり、保証値を表すものではありません

## グンゼ株式会社 電子部品事業部

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-10-4

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA オフィスタワー21F